国泰海通证券股份有限公司

关于江苏神州半导体科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年十一月

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏神州半导体科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国泰海通”）接受江苏神州半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“神州半导体”）的委托，担任其首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本项目”）的保荐人，本保荐人委派程万里和解明天作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号－发行保荐书和发行保荐工作报告》《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等有关规定和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，保荐人和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本发行保荐书，并保证所出具的本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

目 录.....2
第一节 本次证券发行基本情况.....3
一、本次证券发行的保荐代表人的基本情况.....3
二、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员.....3
三、本次保荐的发行人基本情况.....3
四、保荐人和发行人关联关系的核查.....4
五、保荐人内部审核程序和内核意见.....4
第二节 保荐人承诺事项.....9
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺.....9
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺.....9
第三节 对本次证券发行的推荐意见.....10
一、保荐人对本次发行的推荐结论.....10
二、本次证券发行履行的决策程序.....10
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件.....11
四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件.....12
五、发行人及其控股股东等责任主体承诺事项的核查意见.....16
六、发行人符合科创板定位.....16
七、关于发行人私募投资基金股东备案情况的核查结论.....17
八、关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响的核查.....17
九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.....18
十、发行人存在的主要风险.....19
十一、对发行人发展前景的评价.....27

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐代表人的基本情况

本保荐人指定程万里、解明天担任江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

程万里，本项目保荐代表人，曾负责或参与了嘉友国际主板 IPO 项目、嘉友国际可转债项目、嘉友国际非公开发行股票项目、爱科科技科创板 IPO 项目、中芯国际科创板 IPO 项目、宣泰医药科创板 IPO 项目、通达海创业板 IPO 项目、卓海科技北交所 IPO 项目、东贝 B 股转 A 股项目。程万里先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

解明天，本项目保荐代表人，曾负责或参与了宣泰医药科创板 IPO 项目、通达海创业板 IPO 项目、卓海科技北交所 IPO 项目。解明天先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

二、保荐人指定的项目协办人及其他项目人员

（一）项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐人指定史浩博为本次发行的项目协办人。

史浩博：本项目协办人，曾负责或参与了宣泰医药科创板 IPO 项目、通达海创业板 IPO 项目、卓海科技北交所 IPO 项目。史浩博先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（二）项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：沈玉峰、韩锦玮、傅施越、程恺、王祺康、张子尧、王子涵、裘敏杰、李佳。

三、本次保荐的发行人基本情况

发行人	江苏神州半导体科技股份有限公司
英文名称	Jiangsu Shenzhou Semiconductor Technology Co., Ltd.
注册资本	6,600 万元
法定代表人	朱培文

有限公司成立日期	2016-04-26
整体变更为股份公司日期	2025-12-09
住所	扬州市邗江区蜀岗西路 19 号 1
邮政编码	225100
电话	0514-87958862
传真	0514-87958862
互联网网址	https://www.szsemicon.com
电子信箱	ir@asiaexact.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责人	丁昊
联系方式	0514-87958862

四、保荐人和发行人关联关系的核查

1、截至本发行保荐书出具日，本保荐人间接持有发行人 0.2536%的股份。上述情况不会影响本保荐人公正履行保荐职责。除上述情况外，以及本保荐人除按照上交所相关规定，安排相关子公司参与发行人本次发行战略配售以外，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2、除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本发行保荐书出具日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、截至本发行保荐书出具日，本保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

4、截至本发行保荐书出具日，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、截至本发行保荐书出具日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人内部审核程序和内核意见

根据《证券法》《保荐业务管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定以及《证券公司投资银行类业务内部控制指引》的要求，国泰海通制定并完善了

《投资银行类业务内部控制管理办法》《投资银行类业务立项评审管理办法》《投资银行类业务内核管理办法》《投资银行类业务尽职调查管理办法》《投资银行类业务项目管理办法》等证券发行上市的尽职调查、内部控制、内部核查制度，建立健全了项目立项、尽职调查、内核的内部审核制度，并遵照规定的流程进行项目审核。

（一）立项审核

1、立项审核程序

国泰海通证券投资银行业务委员会设立了项目立项评审委员会，通过项目立项评审会议方式对证券发行保荐项目进行立项评审。

立项委员由来自质量控制部审核人员、业务部门、资本市场部资深业务骨干组成，质量控制部负责人牵头负责立项评审委员会相关事宜。

根据各类业务风险特性不同及投资银行业务总体规模等，全部立项委员分为若干小组，分别侧重于股权类业务、债权类业务和非上市公众公司业务的立项评审工作。每个立项小组至少由 5 名委员组成，其中来自投行内控部门人员不少于三分之一。

立项评审会议结果分为通过、不予通过。通过立项的决议应当至少经三分之二以上参与投票立项委员表决通过。

根据项目类型、所处的阶段及保荐风险程度的不同，各项目所需立项次数也不同。首次公开发行股票项目、挂牌项目分为两次立项；发行股份购买资产项目根据项目复杂情况，由质量控制部决定是否需要两次立项；其他类型项目为一次立项。

立项现场（含线上）会议由质量控制部主持，一般按以下流程：

（1）由项目组介绍项目基本情况及尽职调查中发现的主要问题、风险以及解决方案；

（2）由质量控制部主审员及立项委员就关注问题向项目组进行询问；

（3）由项目组对质量控制部主审员及立项委员评审意见进行答复，并于会后提交书面答复意见。

未经立项通过的项目，不得与发行人签订正式业务合同；需经承销立项的项目，未经承销立项通过，不得申请内核评审。

2、初次立项

2025 年 11 月 10 日，本保荐机构召开立项评审会，审议了江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目初次立项申请，并于会后进行了投票。根据投票表决结果通知，5 名评审委员全部同意，初次立项审议通过。

3、承销立项

2026 年 3 月 16 日，本保荐机构立项评审委员会召开会议，审议了江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目保荐承销立项申请，并于会后进行了投票。根据投票表决结果通知，8 名评审委员全部同意，保荐承销立项审议通过。

（二）内核

1、内核程序

国泰海通设立了内核委员会作为投资银行类业务非常设内核机构以及内核风控部作为投资银行类业务常设内核机构，履行对投资银行类业务的内核审议决策职责，对投资银行类业务风险进行独立研判并发表意见。

内核风控部通过公司层面审核的形式对投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制，履行以公司名义对外提交、报送、出具或者披露材料和文件的审核决策职责。内核委员会通过内核会议方式履行职责，对投资银行类业务风险进行独立研判并发表意见，决定是否向证券监管部门提交、报送和出具证券发行上市申请文件。

根据国泰海通《投资银行类业务内核管理办法》规定，公司内核委员会由内核风控部、质量控制部、法律合规部等部门资深人员以及外聘专家（主要针对股权类项目）组成。参与内核会议审议的内核委员不得少于 7 人，内核委员独立行使表决权，同意对外提交、报送、出具或披露材料和文件的决议应当至少经 2/3 以上的参会内核委员表决通过。

国泰海通内核程序如下：

（1）内核申请：项目组通过公司内核系统提出项目内核申请，并同时提交经质量控制部审核的相关申报材料和问核文件；

（2）提交质量控制报告：质量控制部主审员提交质量控制报告；

（3）内核受理：内核风控部专人对内核申请材料进行初审，满足受理条件的，安排内核会议和内核委员；

（4）召开内核会议：各内核委员在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上，结合项目质量控制报告，重点关注审议项目和信息披露内容是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，并独立发表审核意见；

（5）落实内核审议意见：内核风控部汇总内核委员意见，并跟踪项目组落实、回复和补充尽调情况；

（6）投票表决：根据内核会议审议、讨论情况和质量控制部质量控制过程以及项目组对内核审议意见的回复、落实情况，内核委员独立进行投票表决。

2、内核委员会审核

按照相关法律、法规和规范性文件规定以及保荐人《投资银行类业务内核管理办法》的要求，保荐人投资银行类业务内核委员会依照规定程序对发行人本次证券发行上市申请进行了审核。

2026 年 3 月 27 日，保荐人就本项目召开普通程序内核会议。各内核委员在对项目申报文件和材料进行仔细研判的基础上，结合质量控制部出具的质量控制报告，重点关注审议项目和信息披露内容是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，并对质控报告列示需关注的风险、存疑的问题进行了充分讨论和评判，在充分审议的基础上，各内核委员独立、充分发表了审核意见并于会后独立投票表决。

3、内核委员会构成

参加本项目内核会议的内核委员共 9 名，其中来自内部控制部门的委员人数不低于参会委员总人数的 1/3，具体构成为内核风控部 4 人、质量控制部 1 人、合规管理人员 1 人，投行业务部门 1 人，外聘委员 2 人。

4、内核意见

根据内核委员投票表决结果，保荐机构认为江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《保荐管理办法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件。保荐机构内核委员会同意将江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件上报上海证券交易所审核。

第二节 保荐人承诺事项

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。根据发行人的委托，保荐人组织编制了本次公开发行股票并上市申请文件，同意推荐发行人本次证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺

保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会、上交所等有关规定对发行人进行了充分的尽职调查和辅导，保荐人有充分理由确信发行人至少符合下列要求：

（一）有充分理由确信发行人符合法律、法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证本发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会规定的其他事项。

第三节 对本次证券发行的推荐意见

一、保荐人对本次发行的推荐结论

国泰海通作为神州半导体本次证券发行上市的保荐人，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《保荐业务管理办法》和《保荐人尽职调查工作准则》等法律、法规和中国证监会及上交所的有关规定，进行了充分的尽职调查和对发行申请文件的审慎核查。

本保荐人对发行人是否符合首次公开发行股票并在科创板上市条件及其他有关规定进行了判断、对发行人存在的主要问题和风险进行了提示、对发行人发展前景进行了评价、对发行人本次证券发行上市履行了内部审核程序并出具了内核意见。

经过审慎核查，本保荐人内核委员会及保荐代表人认为本次推荐的神州半导体首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《保荐业务管理办法》等法律、法规和规范性文件中有关股票发行并在科创板上市的条件。因此，本保荐人同意推荐神州半导体本次证券发行上市。

二、本次证券发行履行的决策程序

经核查，发行人本次发行已履行了《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等中国证监会及上交所规定的决策程序，具体情况如下：

（一）董事会审议过程

2026 年 2 月 14 日，发行人召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（二）股东会审议过程

2026 年 3 月 2 日，发行人召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了上述与本次发行上市相关的议案。

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

（一）发行人具备健全且运行良好的组织机构

发行人已根据《公司法》及《公司章程》的规定建立了股东会、董事会和监事会，选举了独立董事，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。发行人根据业务运作的需要设置了相关的职能部门，建立健全了内部管理制度，董事、监事和高级管理人员能够依法履行职责，发行人组织机构运行良好。

本保荐人认为，发行人已具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

（二）发行人具有持续经营能力

公司主要从事半导体关键工艺设备核心零部件的研发、生产、销售和技术支持服务，以半导体制造关键工艺技术——等离子体源技术为基础，为我国半导体先进制程产业链提供等离子体高端电源系统产品和全方位技术支持服务。

公司报告期各期扣非净利润均为正，且保持营业收入和净利润的高速增长

未来我国半导体设备核心零部件领域将迎来长期高质量发展，对应行业内企业将迎来良好发展机遇，公司所处行业不存在周期性衰退、产能过剩、市场容量骤减、增长停滞等情况。

公司财务报告审计截止日为 2026 年 6 月 30 日。财务报告审计截止日至本发行保荐书签署日，公司经营情况良好，公司所处行业的产业政策等未发生重大不利变化，公司经营模式、采购、生产、销售情况均未发生重大变化，公司董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员、核心技术人员亦未发生重大变化，也未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

本保荐人认为，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

（三）发行人财务规范，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

经查阅容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2026]210Z0307 号），发行人报告期内财务会计报告被出具标准无保留意见审计

报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

根据发行人的说明、发行人律师出具的《法律意见书》及经本保荐人的核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（五）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件

发行人符合中国证监会规定的其他条件。

四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件

保荐人依据《注册管理办法》对发行人是否符合首次公开发行股票并上市的条件进行了逐项核查，核查情况如下：

（一）发行人符合《注册管理办法》第十条的规定

1、保荐人查验了发行人工商档案，发行人改制设立有关内部决策、审计、评估及验资文件，并核查了发行人现行有效的公司章程及报告期内的财务报表及审计报告。发行人前身神州有限于 2016 年 4 月注册成立，并以股改基准日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算，发行人持续经营时间在三年以上。

经核查，保荐人认为：发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，符合《注册管理办法》第十条的规定。

2、保荐人查阅了发行人历次股东大会（股东会）、董事会、监事会、董事会专门委员会的会议文件，股东大会（股东会）、董事会和监事会议事规则以及相关制度文件。

经核查，保荐人认为：发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

（二）发行人符合《注册管理办法》第十一条的规定

1、保荐人查阅了发行人有关财务基础资料和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]210Z0307 号），核查了发行人的重要会计科目明细账、重大合同、财务制度、经主管税务机关确认的纳税资料等资料。

经核查，保荐人认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

2、保荐人查阅了发行人各项内部控制制度，核查了发行人报告期内重大违法违规情况，并查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]210Z0311 号）。

经核查，保荐人认为：发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

（三）发行人符合《注册管理办法》第十二条的规定

1、符合《注册管理办法》第十二条第（一）款的规定

（1）保荐人查阅了发行人主要财产的权属凭证、相关合同等资料，对发行人运营情况进行尽职调查。经核查，发行人具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，发行人资产完整。

（2）保荐人查阅了发行人股东大会（股东会）、董事会、监事会会议资料，查看了发行人聘任高级管理人员的相关协议，以及对有关人员进行了访谈。经核查，截至本发行保荐书出具日，发行人总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在担任相应职务期间，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他

企业中兼职，发行人人员独立。

（3）保荐人查阅了发行人及其子公司的财务管理制度，对发行人财务部门等有关人员进行了访谈和征询，复核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]210Z0311 号）。经核查，发行人已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策；具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，发行人财务独立。

（4）保荐人查阅了发行人的公司章程、三会议事规则等制度文件，了解发行人的公司治理结构、组织机构和职能部门的设置情况，访谈了发行人相关高级管理人员。经核查，发行人已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形，发行人机构独立。

（5）保荐人取得了发行人控股股东、实际控制人出具的关于避免同业竞争的承诺，查阅了发行人与关联企业签订的相关合同。经核查，发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，发行人业务独立。

综上，保荐人认为：发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）款的规定。

2、符合《注册管理办法》第十二条第（二）款的规定

保荐人核查了发行人重大采购合同及主要供应商等资料，了解发行人主营业务开展情况；查阅了报告期内发行人历次股东大会（股东会）、董事会、监事会及董事会专门委员会会议资料，取得了最近 2 年内发行人核心技术人员名单、简历、劳动合同等资料，对发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况及原因进行了核查。保荐人查阅了发行人工商档案、控股股东及实际控制人出具的说明文件，并复核了发行人律师出具的法律意见书。

经核查，保荐人认为：发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，核心技术人员稳定且最近二年内没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年实际控制人没有发生变更，符合《注册管理办法》第十二条第（二）款的规定。

3、符合《注册管理办法》第十二条第（三）款的规定

保荐人查阅了发行人的经营资料、重大资产权属文件、财务报告和审计报告、企业信用报告等资料，核查发行人涉及诉讼仲裁等情况，并与发行人律师进行了沟通核实，分析相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等，访谈了发行人相关高级管理人员。

经核查，保荐人认为：发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）款的规定。

（四）发行人符合《注册管理办法》第十三条的规定

1、保荐人核查了发行人营业执照、公司章程、主营业务实际经营情况及开展相关业务所涉及的准入许可及相关资质情况，查阅了与发行人所从事行业相关的国家产业政策。

经核查，保荐人认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第（一）款的规定。

2、保荐人核查了报告期内发行人及其控股股东、实际控制人的涉诉情况，通过网络检索查询上述主体涉及诉讼、仲裁、贿赂、行政处罚等相关情形，查阅了相关主管部门出具的合规证明，并与发行人律师进行了沟通核实。

经核查，保荐人认为：最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第（二）款的规定。

3、保荐人取得并查阅了董事、监事和高级管理人员提供的无犯罪证明、调查表及中国证监会等网站检索等资料，核对发行人律师出具的法律意见。

经核查，保荐人认为：发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第（三）款的规定。

五、发行人及其控股股东等责任主体承诺事项的核查意见

保荐人对照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等要求，对发行人及其控股股东、实际控制人、其他主要股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等责任主体公开承诺事项及其未履行承诺时的约束措施进行了核查。

经核查，保荐人认为：发行人及其控股股东、实际控制人、其他主要股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的相关承诺合法有效、内容合理、具备可操作性；未履行承诺的约束措施合法有效，具备可操作性。

六、发行人符合科创板定位

（一）发行人符合行业领域要求

根据《科创属性评价指引（试行）（2024 修订）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》等有关规定，公司科创属性符合科创板定位要求：

公司所属行业领域	☑新一代信息技术	根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》隶属于“新一代信息技术产业（1）”之“电子核心产业（1.2）”之“新型电子元器件及设备制造（1.2.1）”
	☐高端装备	
	☐新材料	
	☐新能源	
	☐节能环保	
	☐生物医药	
	☐符合科创板定位的其他领域	

（二）发行人符合科创属性相关指标要求

发行人具有科创属性，符合《科创属性评价指引（试行）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的要求，公司科创属性的符合情

况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例≥5%，或最近三年累计研发投入金额≥8,000 万元	√是 □否	公司最近三年累计研发投入合计 20,383.07 万元，占最近三年累计营业收入比例为 14.97%，超过 5%且超过 8,000 万元，符合条件
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	√是 □否	截至 2025 年末，公司的研发人员数量为 124 人，占当年员工总数的比例为 24.46%，超过 10%，符合条件
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	√是 □否	截至 2026 年 6 月 30 日，发行人形成主营业务收入的发明专利为 71 项，符合条件
最近三年营业收入复合增长率≥25%，或最近一年营业收入金额≥3 亿元	√是 □否	公司 2025 年营业收入金额为 6.54 亿元，超过 3 亿元，符合条件

七、关于发行人私募投资基金股东备案情况的核查结论

本保荐人核查了如下文件：1、发行人现行有效的工商登记资料；2、全国企业信用信息公示系统公开信息；3、发行人相关机构股东的《私募投资基金证明》及相关基金管理人的《私募投资基金管理人证书》；4、发行人历次增资和股权转让的股东会决议及增资和股权转让协议；5、发行人全部法人股东和合伙企业股东的营业执照、合伙协议等工商资料。

经本保荐人核查，截至本发行保荐书出具日，发行人共有 22 名股东，其中自然人股东 1 名，非自然人股东 21 名。发行人非自然人股东中 16 名股东属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规所规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，该等股东均已完成私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案。

八、关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响的核查

经核查，发行人关于本次发行摊薄即期回报有关事项的议案已经董事会和股东会审议通过，履行了必要的审批程序。发行人关于本次发行对即期回报的摊薄影响分析具备合理性，发行人填补即期回报的措施及控股股东、董事、高级管理人员所做出相关承诺事项符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等相关文件中关于保护中小投资者合法权益的精神及要求。

九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕年 22 号）的要求，国泰海通作为本项目的保荐机构，对国泰海通及发行人是否存在聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行了核查，具体核查情况如下：

（一）保荐机构有偿聘请第三方的核查

经核查，国泰海通在本项目中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方行为，亦不存在未披露的聘请第三方行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的要求。

（二）发行人有偿聘请第三方的核查

经核查，发行人就本项目聘请了保荐机构国泰海通、北京市金杜律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司，以上机构均为本项目依法需聘请的证券服务机构。除此之外，发行人还存在如下有偿聘请第三方行为：

具体情况如下：

（1）聘请深圳汉鼎卓越咨询服务有限公司对本次发行的募集资金投资项目提供可行性分析服务

深圳汉鼎卓越咨询服务有限公司，成立于 2020 年 11 月，负责人为杜智敏，主营业务为募投项目咨询服务等。为了科学地规划募集资金投资项目，顺利完成项目的备案，发行人与深圳汉鼎卓越咨询服务有限公司协商后签订了咨询服务合同，委托其论证和编写募集资金投资项目的可行性研究报告。

（2）聘请北京恒州博智国际信息咨询有限公司对本次发行提供行业顾问服务

北京恒州博智国际信息咨询有限公司，成立于 2007 年 5 月，负责人为林玉光，主营业务为行业咨询服务等。北京恒州博智国际信息咨询有限公司的服务内容为提供行业研究报告。

（3）聘请时美融创（北京）科技发展有限公司对本次发行提供材料打印制

作服务

时美融创（北京）科技发展有限公司，成立于 2024 年 3 月，负责人为张亮亮，主营业务为投行相关业务支持与服务及印务等。该公司同意接受发行人之委托，在本次发行中向发行人提供申请文件整理和咨询服务。

（4）聘请深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司对本次发行提供财经公关服务

深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司成立于 2001 年 3 月，负责人为崔红，主营业务为企业管理咨询、财务咨询、信息咨询、经济信息咨询等。深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司的服务内容为提供媒体关系管理、财经公关顾问等服务。

（5）聘请弗若斯特沙利文对本次发行提供行业顾问服务

弗若斯特沙利文于 1961 年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司。近年来，弗若斯特沙利文报告被广泛引用于科创板上市公司招股文件，其研究能力和数据权威性及客观性已得到市场的广泛认可。弗若斯特沙利文通过弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司为发行人提供服务，服务内容为提供行业研究报告。

经核查，发行人上述有偿聘请其他第三方的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的要求。

十、发行人存在的主要风险

（一）与发行人相关的风险

1、技术风险

（1）新技术、新产品研发失败风险

公司的等离子体电源系统属于半导体核心零部件，主要面向先进制程，需要持续进行高强度的研发投入。报告期内，公司的研发投入合计超过 2 亿元，且呈现高速增长的趋势。公司下游客户主要系国内半导体领域的头部芯片产线和设备厂商，下游客户有着持续的技术迭代需求，核心零部件厂商须持续配合下游客户，

展开相应的技术攻关和研究探索。

在上述背景下，公司须持续进行新技术、新产品的研发，下游市场亦会对新技术、新产品不断提出更高的要求。持续的技术创新能力系公司保持核心竞争力的关键因素，如果公司的技术创新无法跟上行业技术迭代的速度，导致未来相关研发项目无法满足市场需求，或导致相关研发技术与产品无法通过客户验证而实现商业化，则公司可能面临研发失败的风险，将对公司的发展前景和经营业绩产生不利影响。

（2）技术人才流失与核心技术泄密的风险

截至报告期末，公司拥有专利 128 项，其中境内发明专利 72 项，另有软件著作权 71 项，发行人对各项专利及技术等均拥有自主知识产权，并针对全部的核心技术完善了知识产权布局。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 138 人，占员工总数的比例为 24.64%。

核心技术和技术人才是公司保持创新发展的基础。若公司无法持续为技术人才提供更具竞争力的薪酬待遇和发展平台，公司将面临技术人才流失的风险。同时，公司存在因技术人才流失、外界窃取等原因导致核心技术泄密的风险，进而对公司生产经营产生不利影响。

2、经营风险

（1）客户集中及单一客户依赖的风险

公司产品主要面向半导体领域的先进制程，下游主要系半导体设备厂商和芯片产线，由于半导体先进制程领域技术壁垒和投资壁垒较大，下游行业竞争格局呈现集中度较高的状态，导致公司客户集中度亦相对较高。

报告期内，公司前五大客户收入占比分别为 39.31%、61.55%、72.89%及 73.53%，占比较高。公司自研产品批量进入了中微公司、拓荆科技、北方华创等我国头部半导体设备厂商，服务于客户 C、客户 A、客户 B、客户 D 等国内头部芯片产线所致。如果上述主要客户未来的经营状况、技术路线、公司战略、产品价格等发生较大变化，或下游行业竞争格局发生较大变化，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

报告期各期，公司对中微公司销售收入占主营业务收入比例分别为 2.94% 、31.12%、49.19%及 38.89%；对中微公司销售毛利润占公司综合毛利润比例分别为 2.95%、33.90%、52.63%及 43.36%，公司对中微公司具有一定的业绩依赖风险。

如果未来公司无法持续拓展中微公司以外的新客户，或中微公司等主要客户的生产经营情况、经营战略、技术路线、价格等商业条款发生重大不利变化，或行业竞争格局发生重大变化，都将对公司经营业绩产生不利影响。

2026 年 1-6 月，公司对中微销售的主要产品结构有所变化，2024 年及 2025 年主要产品系列的收入有所下降，主要系终端客户对应工艺制程的产线建设进入到尾期，因此需求量有所下降；该终端客户新工艺制程的产线主要需求对应于公司的高压脉冲电源系统产品，已于 2026 年 1-6 月实现业务放量，对冲了产品结构变化影响。

面向半导体先进制程领域的等离子体电源系统产品研发难度较大、技术壁垒较高，且遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的发展规律。未来，若公司未能持续推出新一代的等离子体电源系统产品，可能发生短期内无法胜任下游单一大客户的产品需求的情况。

（2）市场竞争地位变化的风险

等离子体电源系统国产化率较低，市场份额长期被美国、日本等国家的半导体巨头垄断，国内收入成规模的企业相对较少，在自研产品和技术支持服务两个业务板块，公司目前均系国内头部企业，具备较强的市场竞争地位。

一方面，公司依靠多年来的探索与创新，已经具备在先进制程领域对标国际品牌的技术水平，但整体与国际巨头仍存在一定差距，目前仅有技术支持服务业务覆盖了部分国外设备厂商或产线，而自研产品尚未进入国外厂商的供应链；另一方面，随着我国半导体行业的高速增长和国产化进程的不断推进，国内等离子体电源系统市场的竞争亦可能有所加剧。若公司未能持续提升技术水平，保障产品品质并维持核心竞争力，则有可能拉大与国际巨头的差距，或面临更加激烈的竞争，并可能导致公司市场竞争地位发生变化，对公司业绩带来不利影响。

（3）产品商业化进程不达预期的风险

等离子体电源系统属于半导体关键工艺设备中的核心零部件，下游设备厂商和芯片产线对产品性能和稳定性等技术指标有着严苛的要求，一般会经历较长时间的产品验证，才能够导入供应链。公司目前有多款新产品正在客户验证中，若未来公司产品技术水平无法满足客户需求，则可能导致公司产品商业化进程推迟或终止，进而对公司新产品的经营业绩带来不利影响。

3、内部控制风险

（1）管理风险

报告期内，公司业务规模扩张较快，自研产品大规模量产，形成了“自研产品+技术支持服务”的双头发展模式。公司业务规模的增长延伸了公司的管理跨度，增加了公司的管理难度，对公司经营管理能力提出了更高的要求。

本次发行上市后，随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司资产规模和业务规模将进一步扩大，公司经营管理将面临新的考验。如公司管理层管理水平不能适应公司业务规模迅速扩张的需要，则可能影响公司经营效率和盈利水平。

（2）实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人系朱培文，合计控制公司 64.74%的股份对应的表决权。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，但公司实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等施加重大影响，如实施不当将会损害公司及公司中小股东的利益。

4、财务风险

（1）收入高速增长持续性的风险

报告期内，公司营业收入分别为 26,105.54 万元、44,627.90 万元、65,424.00 万元及 37,545.34 万元，最近三年营业收入复合增长率为 58.31%。随着下游客户国产化需求提升，报告期内，公司自研业务增长迅速，收入高速增长。

未来，随着公司收入达到一定规模，可能会出现收入增速放缓的情况，提醒投资者关注相关风险。

（2）毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 62.56%、66.94%、66.65%及 62.56%，处于较高水平，主要原因是公司下游主要系半导体行业，产品面向先进制程，前期研发投入较大，技术壁垒较高，因此产品毛利率相对较高。

公司 2026 年 1-6 月毛利率有所下降，系产品结构变动所致，高毛利率的 AVG 系列、APG 系列射频电源由于终端产线的建设安排及下游技术迭代，销量下降，而对应的新产品高压脉冲电源系统在 2026 年 1-6 月尚未大规模放量。其他新产品如 Advocate 系列射频电源毛利率相对 AVG 系列、APG 系列较低，导致综合毛利率下降。

公司毛利率水平受下游行业需求、市场竞争、销售产品结构、产品价格、原材料价格、人工成本等多种因素的影响，未来若上述因素发生不利变化，可能会导致公司毛利率出现下降的情况。

公司高毛利率产品亦可能由于下游需求变动或技术迭代，出现销量下降的情况。若公司不能持续开发出新一代的产品，或下游需求出现阶段性波动，都可能导致公司产品结构出现波动，进而导致毛利率出现下滑的风险。

（3）存货规模增加及跌价风险

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 11,323.20 万元、19,514.90 万元、21,265.57 万元及 26,995.18 万元，占流动资产比例分别为 36.39%、36.31%、20.38%及 22.95%，存货跌价准备的余额分别为 1,295.17 万元、1,198.40 万元、1,975.23 万元及 2,486.76 万元，占各期末存货账面余额的比例分别为 10.26%、5.79%、8.50%及 8.43%。

存货规模较大对公司的存货管理能力提出了较高要求，若未来由于公司产品更新迭代、市场环境恶化、客户需求变化等不利因素出现订单需求降低的情况，导致某些原材料或在产品不再满足进一步加工需求，或库存商品出现积压，则可能导致存货跌价风险，影响公司运营效率。

（4）应收账款无法及时回收的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,567.47 万元、16,958.26 万元、20,009.11 万元及 25,604.39 万元，占流动资产的比例分别为 27.53%、31.55%、

19.18%及 21.77%。报告期各期末，公司账龄在 1 年以内的应收账款余额保持在90%以上，账龄结构稳定。

随着公司经营规模和营业收入持续增长，未来应收账款余额可能维持在较高水平。公司客户主要为国内半导体芯片产线或设备厂商头部企业，商业信誉及资金实力较强，但客户自身经营状况与现金流水平受到其发展战略、产业政策、市场环境、收入结构及特征等因素影响。若未来产业政策、市场环境等发生不利变化或主要客户经营业绩、信用状况或履约能力发生不利变化，且公司采取的收款措施未达预期成效，公司应收账款可能存在无法及时收回的风险。

（5）汇率波动的风险

报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例分别系 10.94%、8.74%、6.12%及 12.43%。公司外销产品主要以美元结算，汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入，同时由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产，汇率变动同样会影响财务费用。如未来汇率波动幅度扩大，将对公司经营业绩产生一定的影响。

（6）税收优惠政策变化的风险

发行人为高新技术企业，发行人于 2019 年 12 月 5 日通过了高新技术企业的认定，自 2019 年 1 月 1 日起持续享受企业所得税税率为 15%的税收优惠政策，并分别于 2022 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 19 日通过了高新技术企业复审，企业所得税优惠期直至 2027 年 12 月 31 日，覆盖了公司整个报告期。如果国家所得税相关税收政策发生变化，或公司将来未能获得高新技术企业认定导致适用所得税率发生变化，将影响公司的经营业绩。

（二）与行业相关的风险

1、行业周期的风险

公司主要面向半导体行业，产品系半导体设备中的核心零部件。半导体行业在全球范围内均呈现较强的周期性特点。一般来说，新技术的应用和新产品的创新，会带动终端市场的需求，进而带来半导体行业规模的增长。

目前，全球半导体产业进入了由人工智能、云计算、大数据、高速通信等新

技术驱动的新一轮成长阶段。半导体周期的波动以及新技术的应用，将直接影响下游芯片产线对新增产能的战略决策，从而影响其固定资产投资，并最终影响到半导体设备和核心零部件的市场需求。

未来，若因半导体行业周期波动的影响，导致下游芯片产线降低资本开支，则可能会导致半导体设备和核心零部件的市场需求降低，从而对公司自研产品业务板块的收入及利润水平产生不利影响。

2、国际贸易摩擦变化的风险

公司产品及服务主要应用于半导体设备行业。

在自研产品板块，公司主要为国内头部芯片产线和半导体设备企业供货。近年来受国际地缘政治形势影响，国际贸易摩擦有所加剧。若未来相关国家和地区出于贸易保护、地缘政治等原因，进一步通过出口限制等政策加强贸易壁垒，将可能影响国内芯片产线和半导体设备企业生产经营和供应链的稳定性，进而对公司经营发展产生一定的不利影响。公司亦采购了部分海外品牌的元器件，虽然公司不断推进相关元器件的国产化进程，但国际贸易摩擦的加剧仍会对公司供应链稳定产生一定的不利影响。

在技术支持服务领域，为满足半导体行业“精确复制”的特点，公司存在部分采购国际原厂品牌电源系统备机的需求，若国际贸易摩擦加剧，可能导致电源系统备机的价格、交期等受到不利影响。此外，公司技术支持服务客户亦覆盖多个国际知名产线和设备厂商，若国际贸易摩擦加剧，亦可能会影响到相关业务的发展。

3、美国对华跨境投资政策调整的风险

《Provisions Pertaining to U.S. Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern》（简称“《对华投资限制最终规则》”）系美国财政部依据《国际紧急经济权力法》（International Emergency Economic Powers Act，简称“IEEPA”）制定的跨境投资监管专项规则，于 2024 年 10 月发布、2025 年 1 月正式生效。该规则对美国人士等在中国大陆、中国香港及中国澳门地区半导体和微电子、量子信息技术、人工智能系统三大领域的特定投资设置禁止性规定与强制申报要求，违规交易将面临被美国财政部认定无效、

作废、强制剥离对应投资，及民事、刑事追责的法律后果。

截至本发行保荐书出具日，发行人美国背景股东对发行人的历史投资行为不存在违反现行规则的情况。但不排除未来美国有权监管部门修订规则、出台新规或作出不利解释，导致相关投资被认定违规，触发股权强制处置等后果，进而导致发行人股权结构发生重大变动等不利影响，提示投资者关注相关风险。

4、产业政策变化风险

公司报告期内产品主要应用于半导体领域。半导体产业是我国信息技术产业的基础和重要组成部分，半导体行业的发展及国产化的推进对国家产业升级具有至关重要的意义。国家对高质量发展半导体行业高度重视，相继出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》等支持性政策，对行业及公司业务发展起到了积极的促进作用。但若未来国家对半导体相关产业政策发生重大调整，或者下游行业的产业政策出现不利变化，将可能对公司的业务发展或行业需求产生不利影响，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）其他风险

1、募集资金投资风险

（1）募集资金项目实施的风险

公司本次募集资金主要用于“先进工艺节点集成电路领域电源类零部件研发及产业化项目”、“技术支持服务体系升级扩容项目”、“上海产业化基地建设项目”、“技术研发创新中心建设项目”。如果募集资金不能及时或足额到位，或项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、量产达标等不能按计划顺利实施，则会直接影响项目的投产时间、投资回报及公司的预期收益，进而影响公司的经营业绩。

募集资金投资项目建成后，每年将会产生一定的折旧费用和人工支出，公司若不能及时有效的开拓市场，消化新增的产能，将使募集资金投资项目无法按照既定计划实现预期的经济效益。公司存在可能因固定资产折旧和人工成本的增加而导致利润下滑的风险。

（2）新增产能消化不及预期的风险

本次募集资金投资项目达产后，公司产能将在现有基础上大幅提升。在项目建成后，可能出现宏观经济形势变动、下游市场需求变化、市场竞争格局变化等情况，届时将对项目的新增产能消化带来不利影响。

具体而言，公司本次募集资金投资项目完全达产后，各类等离子体电源系统产能相比报告期情况有较大幅度增长，若下游半导体设备领域增速放缓，对等离子体电源系统的需求亦可能有所下降，则公司本次募集资金投资项目达产后的新增产能可能出现消化速度较慢、影响公司产品销售单价及毛利率的情况。

2、发行失败风险

本次发行的发行结果将受证券市场整体情况、公司经营业绩、公司发展前景及投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。公司存在发行认购不足或未能达到预计市值上市条件的情形而导致发行失败的风险。

3、净资产收益率及每股收益被摊薄的风险

本次发行完成后，公司的净资产规模及股本总额将在短期内大幅增长。由于募集资金投资项目存在一定建设周期，且从投产到产生效益需要一定时间，因此，本次发行完成后，如果公司的盈利增幅不达预期，则净资产规模及股本总额的扩大将导致公司的净资产收益率和每股收益出现一定幅度的下降。

十一、对发行人发展前景的评价

（一）行业面临的机遇与风险

1、面临的机遇

（1）国家产业政策扶持为行业发展筑牢制度基础

近年来，我国高度重视半导体产业高质量与可持续发展，陆续出台了一系列顶层规划与产业政策，从发展指引、股权投资、专项支持、研发补助以及税收优惠等多方面，为半导体产业营造了优良稳定的发展环境，全力推动产业实现“强长板、补短板、上规模、上水平”的发展目标。

2026 年 3 月，第十四届全国人民代表大会第四次会议审议通过《中华人民

共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，明确提出要聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破；同期会议听取并审议了国务院《2026 年政府工作报告》，报告明确提出要培育壮大新兴产业和未来产业，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。2025 年 8 月，工信部、市场监督管理总局发布《电子信息制造业 2025－2026 年稳增长行动方案》，明确支持集成电路等领域科技创新，支持先进存储、三维异构集成芯片等前沿技术方向基础研究，坚定不移推动“国货国用”，持续推动短板产业补链、强化关键核心技术攻关，提升元器件、零部件等产品可靠性、安全性。而半导体设备核心零部件，正是我国半导体产业长期存在的短板领域与“卡脖子”关键环节之一，也是上述产业政策重点扶持的主要方向。

综上所述，国家层面持续出台的产业扶持政策，为我国半导体设备核心零部件领域的长期高质量发展提供了坚实制度保障，行业内具备核心自主技术能力的企业将迎来重大发展机遇。

（2）国际供应链格局重构加速国产替代进程

近年来，美国、日本、荷兰等国家持续加大对中国大陆半导体产业链的出口管制力度，管制范围与精度持续升级。2022 年 10 月，美国商务部发布多项对中国大陆半导体出口管制措施，对 18 纳米及以下 DRAM、128 层及以上 NAND 闪存、16 纳米或 14 纳米及以下逻辑芯片相关生产设备实施管控；2023 年 7 月，日本修订后的《外汇及外国贸易法》正式实施，新增 23 类半导体制造设备出口管制品类，覆盖光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗等制程环节；2024 年 12 月，美国商务部更新“实体清单”，新增 140 余家中国相关企业与机构，覆盖半导体制造、关键设备等重要领域；2025 年 1 月，荷兰政府宣布自 2025 年 4 月起，对光刻机、ALD 设备、PECVD 设备、量检测设备等先进半导体设备实施进一步出口管制。

2026 年 4 月，美国参议院两党议员联合发起《硬件技术控制多边协调法案》（简称 MATCH Act），核心目标为封堵中国大陆先进半导体制造能力关键技术突破，核心管控条款包括：一是新增 4 类半导体设备全域管制，对先进制程浸没式 DUV 光刻机、TSV 刻蚀与沉积设备、低温刻蚀设备、钴沉积设备等，对中国大陆实施全面的销售、维修及技术服务禁令；二是对 5 家中国大陆先进制程芯片厂

商及其关联公司，实施类实体清单级别的全维度出口与技术服务管制，覆盖所有受美国《出口管理条例》（EAR）管辖的物项；三是推动日本、荷兰、韩国等盟友国对齐美国多边管制标准，并配套单边兜底规则——若盟友未按时完成管制对齐，美国将通过扩大 EAR 项下外国直接产品规则（FDP）的适用范围，对相关境外半导体设备实施长臂管辖。截至 2026 年 8 月，该法案已获得美国众议院外交事务委员会通过，尚需通过参议院表决、总统签署等环节后方可正式生效。

上述限制措施，使得国内先进制程芯片产线与设备厂商，面临海外原厂设备、核心零部件及配套技术支持服务获取受限的双重困境，尽管短期内可能给国内芯片产线带来供应链波动与断供风险，但从中长期来看，将进一步强化国内半导体产业链全环节实现自主可控的决心，全面加速国内先进半导体设备、核心零部件的国产化替代进程，进而带动产业链相关企业实现快速发展。

（3）中下游产业链日趋完善，夯实行业发展根基

近年来，随着国内半导体“卡脖子”领域技术攻关持续推进，我国半导体设备与半导体制造产业已实现规模化突破，各细分领域布局持续完善，上下游协同发展的正向循环已初步形成。在半导体设备领域，北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测等国产头部厂商，已实现多个细分赛道设备的国产化突破与规模化量产；在半导体制造环节，国内已拥有客户 A、客户 B、客户 E、客户 C、客户 D、华润微等覆盖成熟制程与先进制程的头部芯片制造与半导体器件厂商。中游设备与制造环节的持续成熟，为上游半导体零部件及技术支持服务产业提供了广阔的市场空间与规模化验证土壤。

（4）人工智能技术为行业发展带来新需求

近年来，人工智能技术实现关键性突破，本轮人工智能技术革命催生了大规模、高潜力的市场增量需求。算力中心、具身智能、自动驾驶等下游应用场景进入高速发展期，直接带动高性能 GPU、ASIC 等算力芯片，以及 NAND、HBM 等存储芯片的需求快速增长，强劲的下游需求为半导体全产业链带来了广阔的长期增长空间。

2、面临的风险

（1）半导体设备核心零部件国产化率整体偏低

近年来，国内半导体产业实现快速发展，部分关键设备已逐步实现国产化突破与自主可控，但半导体设备核心零部件领域的国产化程度仍处于较低水平，是国内半导体产业链的核心短板之一。根据弗若斯特沙利文统计，2025 年中国大陆半导体领域等离子体射频电源系统国产化率仅 13%；根据 QYResearch 统计，2025 年中国大陆半导体领域远程等离子体源系统的国产化率不足 7%。上述领域是我国半导体产业亟待发展突破、实现自主可控的重点方向之一。

核心零部件的性能与可靠性，直接决定半导体设备的整体精度、运行稳定性与量产适配性，半导体设备的技术迭代升级，也高度依赖核心零部件的技术突破。因此，核心零部件的自主可控直接关乎我国半导体产业的长期安全发展，是半导体产业链亟待突破的关键卡脖子环节。我国半导体产业全链条自主可控仍任重道远。

（2）行业高端人才短缺

半导体行业属于典型的知识密集型、技术密集型、资本密集型行业，对高端人才的需求较高。由于中国大陆半导体行业起步相对较晚，人才培养和积累相对不足，导致人才供给难以与产业快速扩张的需求相匹配，尤其是高端人才较为匮乏，行业内高端人才供应存在较大的缺口。因此，高端人才短缺对我国半导体行业长期发展构成了一定影响。

（二）发行人的竞争优势

1、公司具备持续研发创新和技术迭代能力

公司自成立以来，始终保持高强度的研发投入，持续深耕等离子体电源系统高端市场，顺利实现了等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统、高压脉冲电源系统等在内的多个产品的商业化落地。目前，公司主要产品的总体性能已达到国际先进水平，并批量应用于国内头部半导体芯片产线，有效突破了海外厂商的长期垄断，实现了高端等离子体电源的自主可控，填补了国内同类产品的技术空白，有力推动了该领域的国产化自主可控。

公司依托较强的研发创新和技术迭代能力，承担及参与了多项国家级重大科研任务攻关。公司系国家高新技术企业，先后获批建设江苏省等离子源工程技术研究中心、江苏省企业技术中心，并获评国家级专精特新重点小巨人企业。

目前，公司已在等离子体电源系统领域构建了完善的核心技术体系，形成了全面的自主知识产权布局，在技术迭代、产品研发与商业化落地方面积累了深厚的行业经验。持续的研发创新与技术迭代能力，是公司保持产品技术先进性、巩固市场竞争力的核心根基。

2、公司具备经验丰富、专业务实的研发技术团队

公司十分重视技术研发团队的建设，打造了行业一流的研发技术团队。截至报告期末，公司研发人员 138 人，占比 24.64%。公司创始团队系国内最早从事等离子体电源系统业务的团队之一，核心人员从业年限均在 10 年以上，且在加入公司之前亦具备较长年限在 MKS、AE 或 EQ GLOBAL 等知名国际半导体厂商或技术支持服务商等的从业经验。

公司创始人朱培文先生拥有 25 年以上行业从业经历，曾作为负责人先后主导了科技部国家火炬计划项目、科技部重大专项子课题等的研发工作，获得了江苏省非公有制经济优秀建设者等个人荣誉；叶剑先生拥有 40 年以上行业从业经历，是上海市集成电路行业协会理事会理事，《半导体视界》国际期刊编委，西交利物浦大学客座教授，中国国际科技促进会半导体产业发展分会专家智库成员，曾在航空/电子领域权威期刊《航空电子技术》《洪都航空》《海军航空大学学报》等发表过多篇文章，曾参与多个航空/电子专用工艺与测试领域的国家级、省级科研项目的研发工作，并曾负责组建 MKS 中国大陆地区技术支持服务团队，担任 MKS 中国大陆地区技术支持服务业务负责人；朱国俊先生、潘小刚先生、尹巧星先生等核心研发团队成员均拥有 10 年以上的行业从业经历。

3、公司自研产品业务具有较强的市场竞争优势

（1）产品定位高端市场，适配半导体先进制程需求

公司产品定位于高端市场，产品系列一经推出便批量导入国内头部半导体设备厂商，适配于国内头部芯片产线。

在等离子体射频电源系统方面，公司产品具有甚高频（最高可达 60MHz）、大功率（最高可达 50kW）等特点，支持多级高频同步脉冲及变频、快速阻抗匹配、多级脉冲匹配、自动功分等功能，适配先进刻蚀、薄膜沉积等工艺；在远程等离子体源系统方面，公司具备自主研发生产其阳极氧化解离腔体的能力，产品

具备高洁净度、耐腐蚀、高稳定性、高解离率、高点火成功率等特点，适配先进薄膜沉积、去胶、清洗等工艺；公司高压脉冲电源系统属于新型刻蚀工艺方案电源产品，具有高电压（最高可达 15kV）、大功率（最大可达 120kW）等特点，支持重构脉冲波形、多级高频同步脉冲及变频等功能，适配先进刻蚀等工艺，已经通过国内先进制程芯片产线的工艺验证，更是未来实现 4XX 层级别芯片制程不可或缺的核心配套技术方案之一。

目前，公司自研的产品已批量导入中微公司、拓荆科技、北方华创等国内头部半导体设备厂商，服务于客户 C、客户 A、客户 B、客户 D 等国内头部芯片产线，可适配 14 纳米及以下逻辑芯片、2XX 层及以上存储芯片等先进制程产线，有力推动了我国半导体先进制程关键工艺设备的国产化进程，为我国半导体先进制程“高深宽比”场景下的三维异构集成等前沿技术突破提供核心底层支撑。

（2）产品性能表现优异，直接参与国际巨头企业竞争

公司始终瞄准世界半导体技术前沿进行自研产品的研发创新，自研产品等离子体射频电源系统、远程等离子体源系统等系列产品总体性能已达国际同类产品水平，并在部分关键技术参数取得领先，成功实现了对国际巨头产品的国产化替代。公司产品性能表现优异，直接参与到与美国、日本等国际巨头企业的充分竞争中，受到了下游头部客户的高度认可。

（3）深度绑定头部客户，构建协同合作生态

目前，公司自研产品已经获得了中微公司、拓荆科技、北方华创等国内头部半导体设备企业的高度认可，成功导入国内头部芯片产线中。凭借过硬的产品与服务能力，公司斩获多项行业权威奖项，并获得头部客户的高度认可：荣获 2026 年中国证券报“2025 年度新质企业金牛奖（人工智能）”、荣获 2026 年 SEMICON “年度新锐企业奖”、中国 IC 独角兽联盟“2024-2025 中国半导体产线电源领军企业”“2024-2025 中国半导体产线电源最佳解决方案”、2026 年中微公司供应商“合作创新奖”“卓越质量进步奖”、2025 年拓荆科技全球合作伙伴“协作创新奖”等。

由于半导体制造的高度复杂特性和强协同耦合特性，在先进制程的技术攻关中，行业内普遍采取芯片厂商、设备厂商与核心零部件厂商上下游协同研发创新

的模式。公司作为等离子体电源系统领域的先进企业，已与多家国内头部半导体设备厂商、芯片厂商建立了紧密的协同研发合作关系，深度参与其新一代制程及配套设备的研发创新，为其提供相应核心零部件解决方案，为公司持续深化市场渗透、提升市场份额奠定了坚实基础。

4、公司技术支持服务业务具有较强的市场竞争优势

（1）市场份额位居行业前列，具备领先市场地位

公司经过多年行业深耕，已成为等离子体电源系统领域国内规模领先的技术支持服务供应商，服务能力覆盖几乎全部主流品牌的全部型号产品，为我国半导体芯片产线破解“停机风险”，保障产线稳定、持续运转提供有力支撑。根据 QYResearch 统计，2025 年公司在中国大陆等离子体电源领域技术支持服务市场份额排名第一。

对于下游芯片产线客户来说，技术支持服务直接关系到产线的安全生产与稳定运行，因此对技术支持服务商的遴选要求较为严苛，不仅有着较长时间的验证周期，还会重点考察供应商的过往业绩、行业口碑与市场影响力等。

公司作为中国大陆领先的等离子体电源系统技术支持服务商，有着丰富的过往业绩和广泛的行业影响力，在竞争中可以处于有利地位。

（2）完善的全国服务网点布局，可以快速响应客户需求

等离子体电源系统作为刻蚀设备、薄膜沉积设备等半导体关键工艺设备的核心零部件，若其出现故障，则可能直接导致产线出现停机风险，造成较大的经济损失。因此，下游芯片产线客户通常对技术支持服务有着快速响应的要求，以保障生产的安全稳定。

公司围绕国内核心半导体产业集群与重点客户，已经布局了较为完整的技术支持服务网络，技术支持中心遍布北京、上海、深圳、武汉、沈阳、大连等国内头部半导体产线所在地区，以便快速响应产线客户需求，为其提供高质量、高效率的技术支持服务。

（3）优质广泛的客户资源优势，进入了国际巨头供应链

公司具备较强的客户资源优势。通过多年的积累，公司的技术支持服务已覆

盖客户 A、台积电、英特尔、三星电子、SK 海力士、美光科技、德州仪器、客户 B、客户 C、客户 D、华润微等国内外主流芯片产线，以及应用材料、中微公司、拓荆科技、北方华创等国内外知名半导体设备厂商。

国际半导体巨头对供应商有着远高于行业平均水平的验证标准与准入门槛。公司是中国大陆地区少数同时进入美国、韩国等半导体巨头供应链的等离子体电源系统技术支持服务商之一，服务于英特尔、三星电子、SK 海力士、美光科技、德州仪器、应用材料等知名企业，相对于其他竞争对手，有更高的国际化视野和行业影响力。

5、公司自研产品业务和技术支持服务业务双向协同，可以相辅相成，共同发展

公司秉承自研产品业务和技术支持服务业务双线发展的发展路径，两个业务板块相辅相成，具有较强的协同作用。

公司成立初期以等离子体电源系统技术支持服务为主，深度服务国内外主流芯片产线。通过长期一线产线的实战沉淀，公司不仅实现了业务规模的持续增长，更精准的掌握了一线产线的具体需求，深刻理解主流等离子体电源系统的技术路线与应用场景，积累了大量一线工艺适配经验与技术诀窍（Know-How）。这些核心积累为自研产品业务提供了较为明确的研发方向，使公司能够紧扣产线生产需求开展针对性研发，有效提升研发效率、缩短客户验证周期等；同时，技术支持服务业务稳定的盈利能力，为自研产品业务提供了持续的研发投入保障，支撑多条产品管线研发项目的顺利推进，是公司实现等离子体电源系统国产替代快速突破的核心基础。

报告期内，公司自研产品进入大规模量产阶段，收入规模快速增长。随着自研产品陆续过保，也将为技术支持服务板块带来增量业务需求；同时，公司通过自研产品打磨形成的核心技术体系又可全面复用至技术支持服务业务，有效提升维修精度、服务效率与复杂工艺场景适配能力等，进一步巩固了公司在国内技术支持服务市场的领先优势。

两大业务板块齐头并进、循环赋能，不仅显著增强了客户粘性与综合市场竞争力，更有效平滑了半导体行业周期波动对公司业绩的潜在影响，为公司长期稳

定增长提供了坚实保障。

（三）发行人的本次募集资金投资项目

本次股票发行后，募集资金扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	实施主体	投资项目备案号	环评批复
1	先进工艺节点集成电路领域电源类零部件研发及产业化项目	104,896.82	82,169.82	发行人	扬维开行审备[2026]22 号	不适用
2	技术支持服务体系升级扩容项目	27,061.27	27,061.27	发行人	扬维开行审备[2026]11 号	不适用
3	上海产业化基地建设项目	53,451.90	53,451.90	全资子公司	上海市企业投资项目备案证明（项目代码：2602-310115-04-02-846744）	不适用
4	技术研发创新中心建设项目	55,643.34	55,643.34	全资子公司	上海市企业投资项目备案证明（项目代码：2602-310115-04-02-954388）	不适用
合计		**241,053.33**	**218,326.33**	-	-	-

公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金，本次发行募集资金到位后，如本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，超出部分将用于补充公司营运所需要的流动资金。

本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金或银行借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。如本次实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，缺口部分由公司以自筹方式解决。

本次募集资金的实施有助于巩固并提高公司的市场地位，提升公司的综合竞争力，有利于支撑公司主营业务发展，助力于实现公司的未来经营战略。

综上，本保荐人认为发行人具有良好的发展前景。

（以下无正文）

附件：

《关于江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票保荐代表人专项授权书》

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏神州半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签章页）

项目协办人：

史浩博

保荐代表人：

程万里　　解明天

保荐业务部门负责人：

郁伟君

内核负责人：

杨晓涛

保荐业务负责人：

郁伟君

总经理（总裁）：

朱　健（代）

法定代表人（董事长）：

朱　健

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 1 月 16 日

关于江苏神州半导体科技股份有限公司

首次公开发行股票保荐代表人专项授权书

本公司已与江苏神州半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”）签订《江苏神州半导体科技股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”），为尽职推荐发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”），持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等相关义务，本保荐机构指定保荐代表人程万里（身份证号：3209811990********）、解明天（身份证号：2202021994********）具体负责保荐工作，具体授权范围包括：

1、协助发行人进行本次保荐方案的策划，会同发行人编制与本次保荐有关的申请材料。同时，保荐机构根据发行人的委托，组织编制申请文件并出具推荐文件。

2、保荐代表人应当对发行人本次发行申请文件中有中介机构及其签名人员出具专业意见的内容进行审慎核查，其所作的判断与中介机构的专业意见存在重大差异的，应当对有关事项进行调查、复核，并有权聘请其他中介机构提供专业服务，相关费用由发行人承担。

3、协调发行人与中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司的联系，并在必要时根据该等主管机构的要求，就本次保荐事宜作出适当说明。

4、保荐代表人的其他权利应符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定和双方签订的《保荐协议》的约定。

保荐代表人（签字）：

程万里

保荐代表人（签字）：

解明天

法定代表人（董事长）：

朱 健

授权机构：国泰海通证券股份有限公司

（公章）

2026 年 1 月 16 日